



TIF® 800SE 一款在满足顶级散热需求的同时兼顾优异组装工艺性的高端可压缩型导热垫片。它通过创新的材料配方，成功实现了超高导热率与适中硬度的理想结合。这种独特的性能配比，使其既能高效应对超高热流密度带来的散热挑战，又具备了良好的机械强度和可压缩性，便于生产加工与安装，为高功率密度电子设备提供了兼具卓越散热效能与高可靠性的界面材料解决方案。

特性

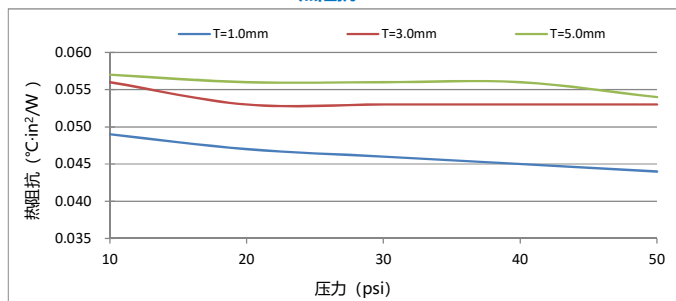
- 》优异的热传导率
- 》良好的柔软性和填充性
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》良好的绝缘性能

应用

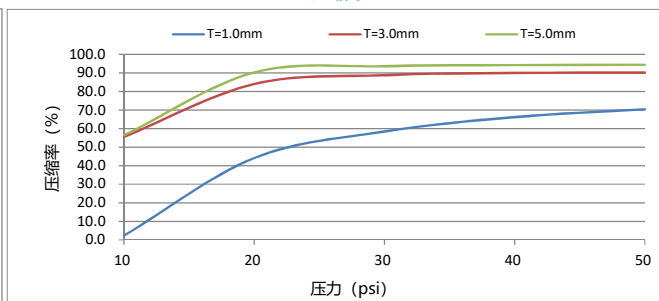
- 》AI服务器
- 》半导体封装
- 》低空飞行器
- 》光通信产品
- 》5G基站

| TIF® 800SE 系列特性表 | | | |
|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| 产品特性 | 典型值 | | 测试方法 |
| 颜色 | 灰色 | | 目视 |
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶 | | - |
| 厚度范围 (inch/mm) | 0.030 0.75 | 0.040~0.200 1.00~5.00 | ASTM D374 |
| 硬度 (Shore OO) | 35 | 35 | ASTM D2240 |
| 密度 (g/cm³) | 3.25 | | ASTM D792 |
| 建议使用温度范围 (°C) | -40 ~ 200 | | - |
| 击穿电压 (V/mm) | ≥5500 | | ASTM D149 |
| 介电常数 @1MHz | 8.0 | | ASTM D150 |
| 体积电阻率 (Ohm-cm) | > 1.0×10 ¹² | | ASTM D257 |
| 导热系数 (W/m·K) | 15.0 | | ASTM D5470 |
| | 15.0 | | ISO22007 |
| 阻燃等级 | V-0 | | UL94 (E331100) |

热阻抗



压缩率



产品规格

标准厚度: 0.030" (0.75 mm) ~0.200" (5.00 mm)，以 0.010" (0.25 mm) 为增量。
标准尺寸: 16"×16" (406 mm×406 mm)

TIF® 系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

产品型号说明

TIF8 00 SE

- 导热系数: 15.0 W/m·K & 硬度: 35
- 厚度: 30mils ~ 200mils
- 产品系列

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
 台湾: +886-2-2277-1007
 加拿大: +001-604-2998559
 越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIF800SE-1225